

全自動テープ貼り替え（転写）装置 Fully Automatic Wafer Remounting Machine

【概要 - Outline -】

◆本装置はフレームカセットから供給されたダイシングフレームにマウントされたウェーハもしくは、

This machine is a wafer remounting machine. The operation sequences are firstly; loading a wafer-mounted or chip-mounted frame from a frame cassette,

チップ部分のみをカットし、別のダイシングフレームへ貼付けを行う転写装置です。

cutting out the wafer or the chip from the dicing frame, then, mounting the wafer on another dicing frame.

貼付後、供給時に貼付けされていた裏面のダイシングテープの剥離も行います。

After mounting, the dicing tape on the back of the wafer is removed and lastly stored in a frame cassette. The ideal system for mounting wafers to dicing frames, before the dicing process.

【特長 - Features -】

◆オールインワンで多彩な機能を搭載。

This is all-in-one machine with various functions.

(オプションでUV照射機能、テープエキスパンド機構、バーコード/ウェーハID読み取り機構、真空貼付け機構追加可能)

(UV irradiation function, tape expanding function, barcode / wafer ID reading function, laminating function in a vacuum chamber can be added as option.)

◆小チップから大チップまで転写可能。

Small chips and large chips are available to remount.

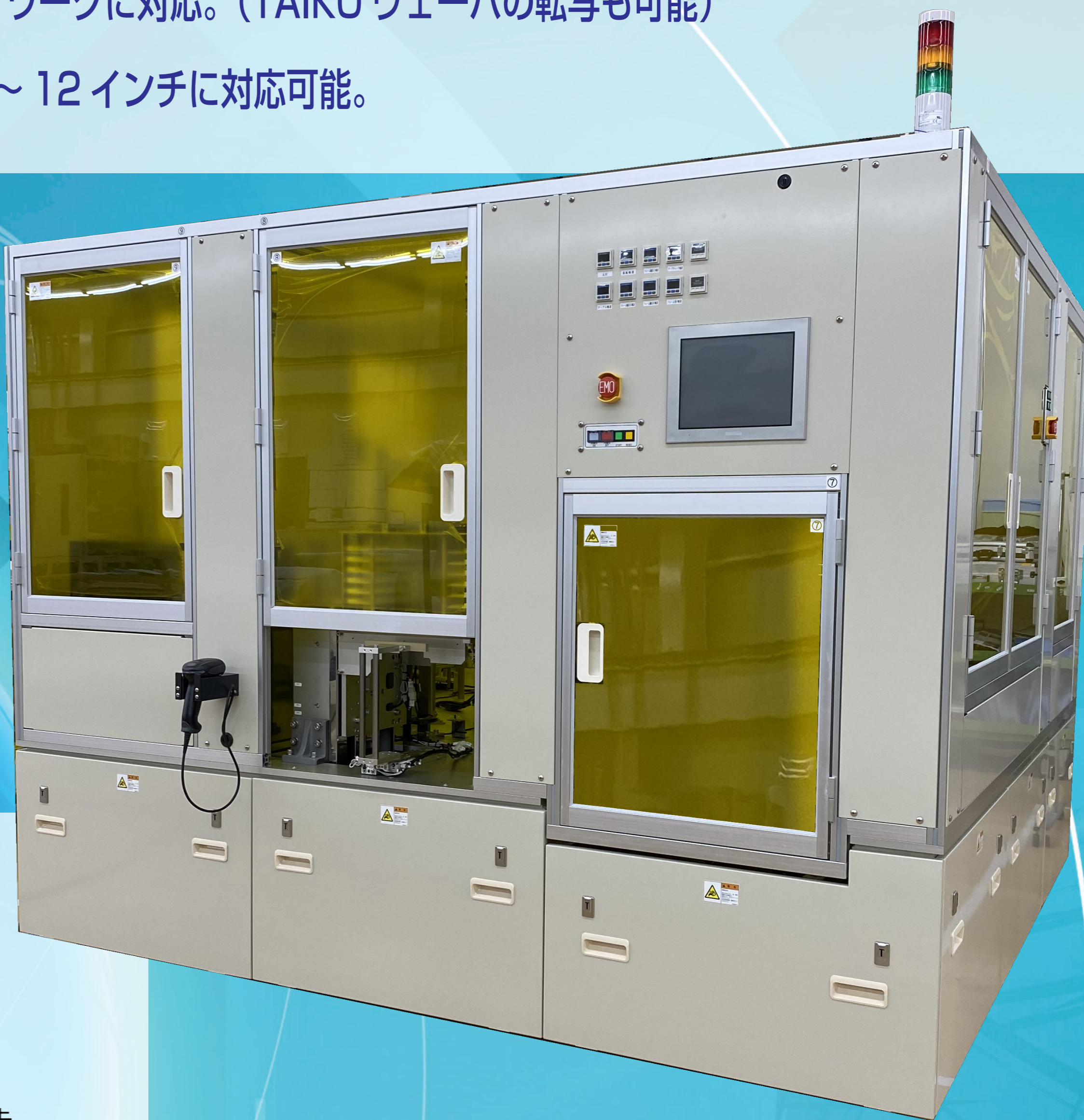
◆ロールテープ/プリカットテープを含む多種フィルム、ワークに対応。(TAIKO ウェーハの転写も可能)

Various films including roll tape / pre-cut tape and wafers are available (TAIKO, too).

◆ウェーハサイズは4～12インチ、リングフレーム6～12インチに対応可能。

Wafer size is 4 to 12 inches and the frame size is 6 to 12 inches.

お客様の様々な
プロセスに対応します



【転写フロー】

